8410

製品案内

熱活性粘着フィルム

製品の説明

tesa® HAF 8410は反応型フェノール樹脂とニトリルゴムを主成分にした熱活性両面接着フィルムです。 ICスマートカードのチップモジュールの装着、金属、アルミ、プラスチックの接着、FPCBとPCBの固定等に最適です。

特徴

- Reliable chip module bonding
- Suitable for PVC, ABS, PET, and PC cards
- Good workability on all common implanting lines
- Outstanding ageing resistance
- Lifelong flexibility due to high rubber content

用途

- PVC、ABS、PET、PC等の各種カード材質に
- 全てのICカード装着ラインに
- 優れた耐老化性
- ゴム成分を含有し長期間柔軟性を保持

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	無し	• 総厚	60 µm
• 粘着剤	ニトリルゴム・フェノール樹脂混合物	• 色	琥珀色
• ライナー	グラシン		

特性 / 性能

• 接着力（動的剪断）	12 N/mm²

備考

技術的な推奨値（スマートカードの場合）

作業の開始にあたり、装置の設定条件として下記数値を推奨いたします。装置の形式、特にカード本体及びチップモジュールの材質により最適な条件が左右しますので、予めご留意下さい。

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=08410

8410

製品案内

備考

仮接着条件：

仮接着工程は、HAFをモジュールベルト上に貼りつける工程です。この工程は、インライン、オフラインのどちらでもおこなうことが可能です。

温度：130-150℃、圧力：4-6bar、時間：1.5-3.0秒

モジュールの接着：

モジュールの装着工程では、仮接着されたモジュールをモジュールベルトから打ち抜き、カードの溝にはめ込み、さらに熱を加えてカード本体に永久接着させます。この工程では、厳密には装着ラインの型式などで取り扱いが異なりますが、条件が大きく変わることはありません。

1回の加熱工程の場合：

低温硬化=温度：160-180℃、圧力：15-35bar、時間：2.0-4.0秒

高温硬化=温度：180-200℃、圧力：15-35bar、時間：1.0-1.5秒

2回以上の加熱工程の場合：

温度（加熱冶具の内部温度を測定）：170-200℃、

圧力：15-35bar、時間（各ステップ毎）：0.7-1.2秒

8410

製品案内

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=08410